

Chapter E: BGA

3. Background Information

3.1 Reports

IVF Rapport 95017 "Övergripande elektriska och termiska krav," A. Sihlbom, H. Svärd (in Swedish)

IVF Rapport 95037 "Sammanställning av möjliga felmekanismer på kretskortsnivårelaterade till tillverkning och driftsmiljö för primärt BGA- och QFP-komponenter", P.-E. Tegehall (in Swedish)

IVF Rapport 95038 "Redovisning av förväntade felmekanismer på kretskortsnivå för BGA- och QFP-komponenter i fordons elektronik", P.-E. Tegehall (in Swedish)

IVF Rapport 95039 "Sammanställning av miljöprovningmetoder för utvärderingen av tillförlitligheten av BGA- och QFP-komponenter", P. Carlsson, P.-E. Tegehall (in Swedish)

IVF Rapport 95040 "Val av preliminära miljöprovningmetoder för BEE-projektets testprogram", P.-E. Tegehall (in Swedish)

Rapport EPF R-79, "Ball Grid Array (BGA) Teknologi," 1997 (in Norwegian)

3.2 Papers

Paper "A comparative study of ball grid array and ultra fine-pitch QFP technologies using solder paste stencil printing," Rörgren, P. Carlsson, J. Liu, Proceedings Surface Mount International, San Jose, CA, Aug 29-31, 1995.

Paper "Tailoring of a test programme for evaluating the reliability of plastic BGA packages in automotive environments," P. Carlsson, R. Rörgren, P.-E. Tegehall, Proceedings Semicon/Europe, Geneva, Switzerland, March 1996.

Paper "Reliability of Ball Grid Array Packages in an Automotive Environment," R. Rörgren, P.-E. Tegehall, P. Carlsson, Proceedings Surface Mount International, San Jose, CA, September 7-11, 1997.

Paper "Test Methods and Reliability Evaluation of BGA Packages for Automotive Electronics," R. Rörgren, P.-E. Tegehall, P. Carlsson, Proceedings ISHM -Nordic, Oslo, Norway, September 21-24, 1997.

Paper "Reliability of BGA Packages in an Automotive Environment," R. Rörgren, P.-E. Tegehall, P. Carlsson, SMTA Journal of Surface Mount Technology, Vol. 11, Issue 2, pp. 35-44, April 1998.

